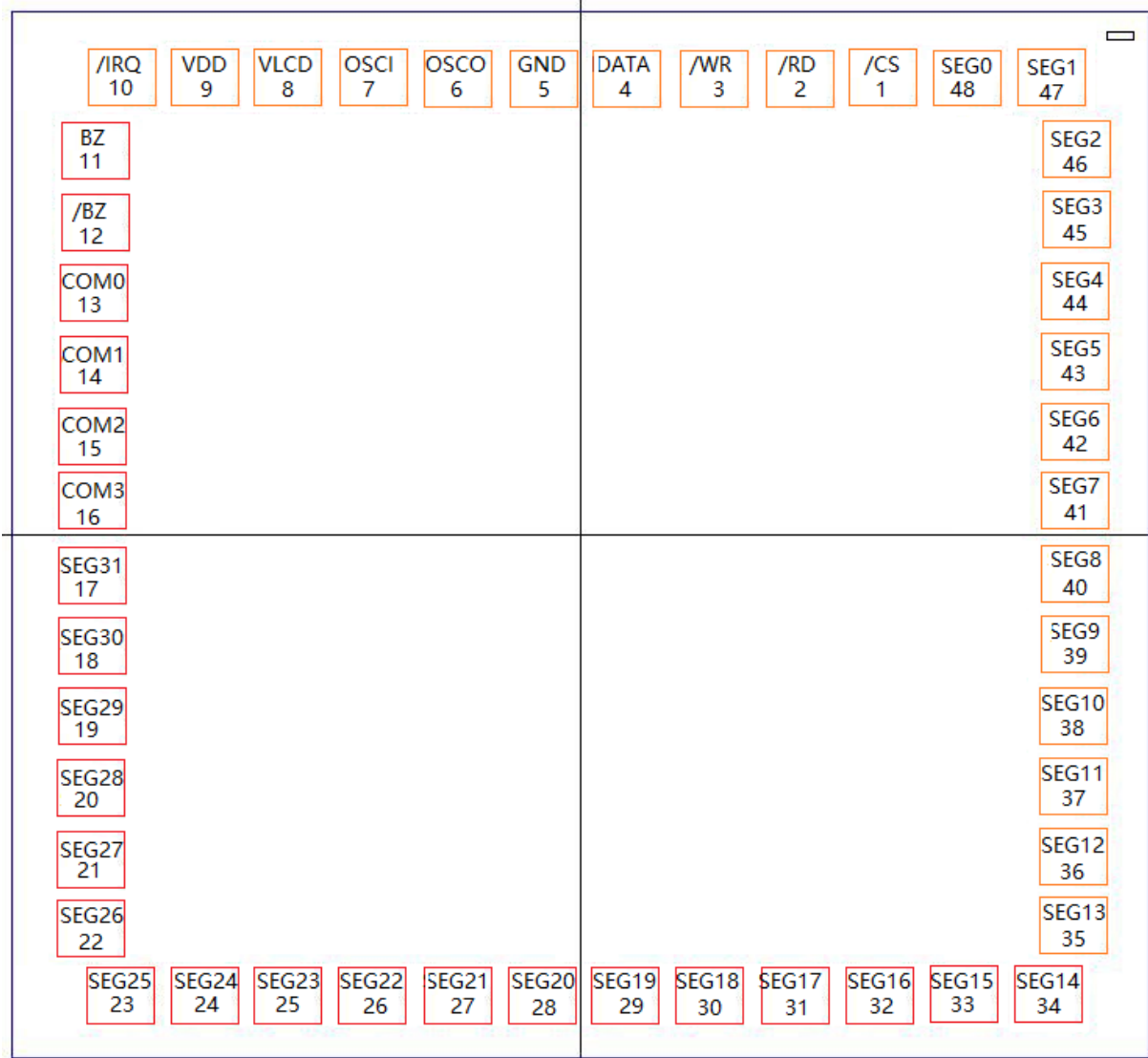


## VK1621B COB资料

### COB PAD图



芯片面积：1630×1755 um<sup>2</sup> ，衬底电位：VDD

PAD 大小：90×90 um，间距：112 um，铝垫大小：100×100 um，铝垫厚度：1um

说明：VLCD≤VDD

## COB PAD坐标

序号	名称	X坐标	Y坐标	序号	名称	X坐标	Y坐标
1	/CS	411.5	732.9	25	SEG23	-397.5	-738
2	/RD	298.5	732.9	26	SEG22	-282.5	-738
3	/WR	185.5	732.9	27	SEG21	-167.5	-738
4	DATA	63	732.9	28	SEG20	-52.5	-738
5	GND	-52	732.9	29	SEG19	62.5	-738
6	OSCO	-167	732.9	30	SEG18	177.5	-738
7	OSCI	-282	732.9	31	SEG17	292.5	-738
8	VLCD	-397	732.9	32	SEG16	407.5	-738
9	VDD	-512	732.9	33	SEG15	522.5	-738
10	/IRQ	-627	732.9	34	SEG14	637.5	-738
11	BZ	-664.5	619.8	35	SEG13	675.5	-626
12	/BZ	-664.5	494	36	SEG12	675.5	-513
13	COM0	-664.5	382	37	SEG11	675.5	-400
14	COM1	-664.5	270	38	SEG10	675.5	-287
15	COM2	-664.5	158	39	SEG9	675.5	-174
16	COM3	-664.5	46	40	SEG8	675.5	-61
17	SEG31	-664.5	-66	41	SEG7	675.5	52
18	SEG30	-664.5	-178	42	SEG6	675.5	165
19	SEG29	-664.5	-290	43	SEG5	675.5	278
20	SEG28	-664.5	-402	44	SEG4	675.5	391
21	SEG27	-664.5	-514	45	SEG3	675.5	504
22	SEG26	-664.5	-626	46	SEG2	675.5	617
23	SEG25	-627	-738	47	SEG1	637.5	732.9
24	SEG24	-512.5	-738	48	SEG0	524.5	732.9